

株主様向け  
アンケート

## 株主の皆様の声をお聞かせください

当社では、株主の皆様の声をお聞かせいただくため、アンケートを実施いたします。お手数ではございますが、アンケートへのご協力をお願いいたします。

下記URLにアクセスいただき、  
アクセスコード入力後に表示される  
アンケートサイトにてご回答ください。  
所要時間は5分程度です。

 <http://www.e-kabunushi.com>  
アクセスコード 4975

いいかぶ

検索

Yahoo!、MSN、exciteのサイト  
内にある検索窓に、いいかぶと  
4文字入れて検索してください。



空メールによりURL自動返信

kabu@wjm.jpへ空メールを送信してください。(タイトル、本文は無記入)  
アンケート回答用のURLが直ちに自動返信されます。



携帯電話からもアクセスできます

QRコード読み取り機能のついた携帯電話をお使い  
の方は、右のQRコードからもアクセスできます。



●アンケート実施期間は、本書がお手元に  
到着してから約2ヶ月間です。

ご回答いただいた方の中から  
抽選で薄謝(図書カード500円)  
を進呈させていただきます



※本アンケートは、株式会社エーツーメディアの提供する「e-株主リサーチ」  
サービスにより実施いたします。(株式会社エーツーメディアについての詳細  
<http://www.a2media.co.jp>) ※ご回答内容は統計資料としてのみ使用させ  
ていただき、事前の承諾なしにこれ以外の目的に使用することはありません。

●アンケートのお問い合わせ TEL: 03-5777-3900(平日 10:00~17:30)  
「e-株主リサーチ事務局」 MAIL: info@e-kabunushi.com



## 株主メモ

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月
基準日	定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日
公告方法	電子公告により、当社ホームページ ( <a href="http://www.jcu-i.com/">http://www.jcu-i.com/</a> )に掲載いたします。なお、 やむを得ない事由により、電子公告によることが できないときは、日本経済新聞に掲載して行うもの とします。
株主名簿管理人	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
同事務取扱場所	東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部
電話お問合わせ先・ 郵便物送付先	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-288-324(フリーダイヤル)
証券コード	4975
金融商品取引所	東京証券取引所市場第一部



## 荏原ユーザライト株式会社

〒110-0016 東京都台東区台東4-19-9 山口ビル7  
TEL: 03-3833-0321 FAX: 03-3833-5075  
<http://www.jcu-i.com/>



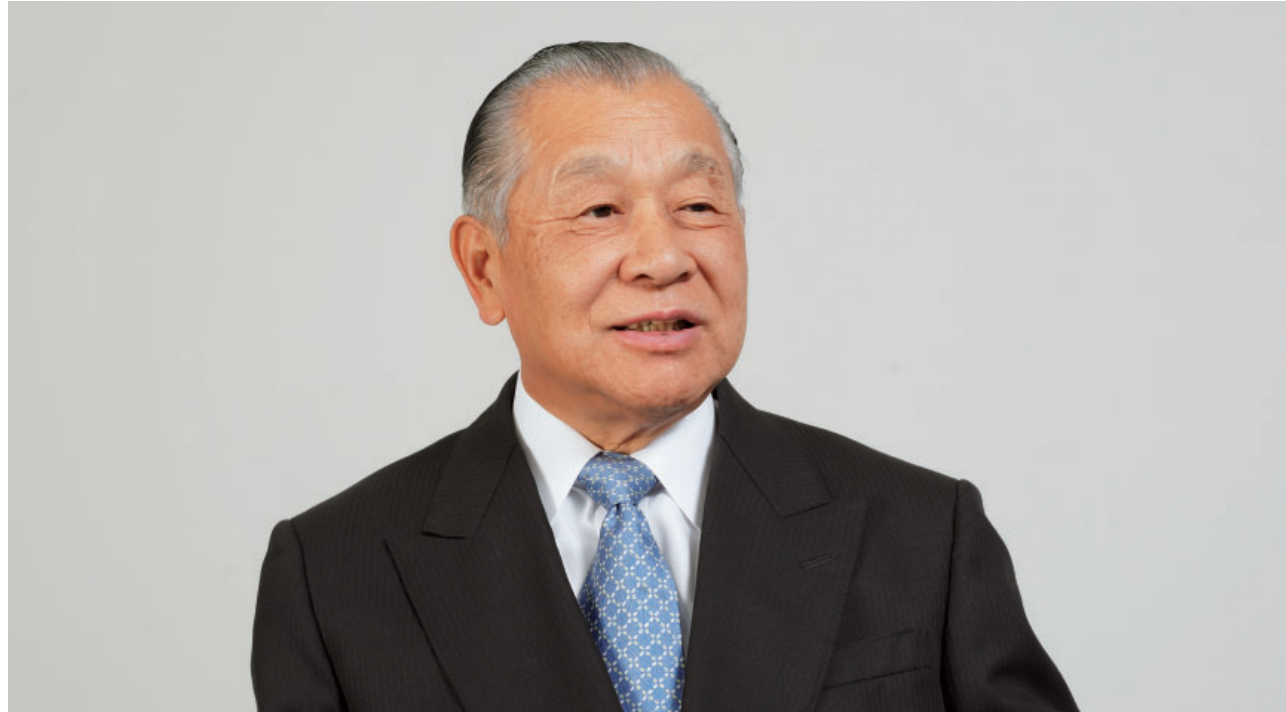
第51期 中間報告書 2010.4.1-2010.9.30

株主・投資家のみなさまへ

THE 51st BUSINESS REPORT

JCU (荏原ユーザライト株式会社)

証券コード: 4975



代表取締役会長兼CEO

高橋 健児

### 株主・投資家のみなさまへ

株主・投資家のみなさまには、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、当社グループの第2四半期連結累計期間の決算につきましては、国内、海外子会社合計で売上高58億9百万円、営業利益6億72百万円、経常利益6億60百万円、四半期純利益3億19百万円となりました。

### 国内の状況

当上半期を振り返りますと、自動車業界は、第1四半期同様にエコカー減税の効果もあって比較的好調に推移いたしました。その要因として国内需要だけでなく、中国、アメリカなどへの輸出も好調に推移したものと考えております。

一方半導体、プリント配線板の業界は前期に引き続き、順調に推移いたしました。特に第1四半期より事業を譲り受けました荏原電産株式会社のエッチング薬品の販売とその相乗効果も加わり、自社製薬品の売上高は前期上半期に比べ、56%の売上増となりました。

### 海外の状況

当社の海外子会社薬品売上高及び海外顧客向け輸出は第2四半期累計で約18億円となり、これは当社薬品売上高全体の42%に相当いたします。このところ80円台そこそこの円高為替水準を考えに入れますと、実際の比率はもっと高いものと考えております。

中国の自動車業界は前期同様好調に推移しており、9月末の時点ですでに1,200万台に近い数字まで生産台数が伸びていると聞いております。日本の自動車部品会社の中には、一時期15~20%の大幅賃上げ要求で操業停止状況に追い込まれたことがあったとニュース等で聞きましたが、全体的には当社の薬品の売上状況から見れば、日系企業も善戦したと思われる。

中国では、案外日系企業の車が好まれ、特に富裕層は安心や安全という付加価値も含めた高級な日本車を求めているのだと思います。世界で最も環境にやさしく、安全で快適な日本の車は、ヨーロッパの小型車同様今後も積極的に購入されていくものと思われます。

一方、プリント配線板薬品については、ITバブル以来の好景気です。特に、アップル社の携帯電話やモバイル音楽プレーヤー、その他各社スマートフォンの販売が爆発的に好調で、韓国や台湾の大手プリント配線板メーカーや日本から中国にシフトしているプリント配線板メーカーも、その恩恵を受けていると思われます。

下半期も継続して推移するかどうかは疑問視する企業もあり、不透明な市況ではありますが、韓国や台湾大手メーカーに関する限り、今も強気の投資をしています。その投資の対象は、来年以降で本格導入されるエニーレイヤー（Any Layer）構造に転換しようとの動機からです。エニーレイヤー構造とは、従来のコア層がなく、更に各層間を全てフィールドビアで接続した特徴を持ちます。この工法を導入することにより、HDI（High Density Interconnection）だけでなく、CSP（Chip Size Package）やFC（Flip Chip）市場にも低コストで参入が可能となります。従来の銅や銀による導電性ペーストに比べ、穴あけ作業もレーザーだけで済み、銅めっきフィールドも従来のめっき装置で加工できるため、従来の工程よりエニーレイヤー構造のほうが安価でかつ配線抵抗の少ない微細回路形成ができます（エニーレイヤーの詳細については、P5の経営トピックスをご覧ください）。これにより、特に市場規模の膨らむスマートフォンや電子書籍基板において、より優れた性能をご提供できる自信があります。そして、ここに使用される薬品こそが当社の最も得意とするVFシリーズなのです。VFⅡ及びVFⅣは上半期だけで売上高7億45百万円に達しておりますが、現在完成間近のVFⅤもエニーレイヤー対応となっておりますので、来期は更に売上増が期待できます。

従いまして、当社の国内外の上半期決算はリーマンショック以降の低迷状態を脱し、通期予想で売上高120億40百万円、営業利益13億円、経常利益12億60百万円、当期純利益7億円となり、営業利益及び経常利益としては過去最高益を見込んでおります。

## 主な新規事業の進捗状況

### 1. ボルト・ナット類のコーティング事業

本年8月末に大手ボルト・ナットの製造メーカーの下請け会社へ実機を据付完了し、テスト生産に入っており、大手自動車メーカーの認定がおり次第、本格生産に移行するところまで来ております。具体的には、亜鉛めっき後、当社の三価のクロメート処置してから、黒色コーティングを施すタイプです。それによって、低コストで高耐食性が得られます。下半期には本格生産が開始できると考えております。

### 2. 太陽光反射防止膜コーティング事業

すでに台湾の大手太陽光パネルメーカーと共同して、小型の太陽パネルを使い、性能と耐久性テストなど20年～25年の保証条件に見合う各種性能テストが実施されました。その性能について一定の効果を確認した上で、1mX1m及び1mX1.8mの大型パネルテストに入る直前にあります。

実機テストの結果がよければ、台湾、中国、韓国、日本などでそれぞれのパートナーを見つけ、ガラスコーティング合弁事業として本格参入する予定であります。何しろ大きな事業なので、しっかりとした性能確認テストをした上でないと新たな投資はできないと考えております。乞うご期待ください。

### 3. スパッタリングによるカラーリングとハードコーティング事業

中国の深圳において、深圳森荏真空鍍膜有限公司という合弁会社を立ち上げ、携帯電話や時計などのカラーリング事業としてスタートし、現在お客様に依頼された量産テストを順調に行っております。自己修復機能のあるコーティ

ング事業も並走しており、これからが勝負の時と考えております。

### 4. プラズマ装置事業

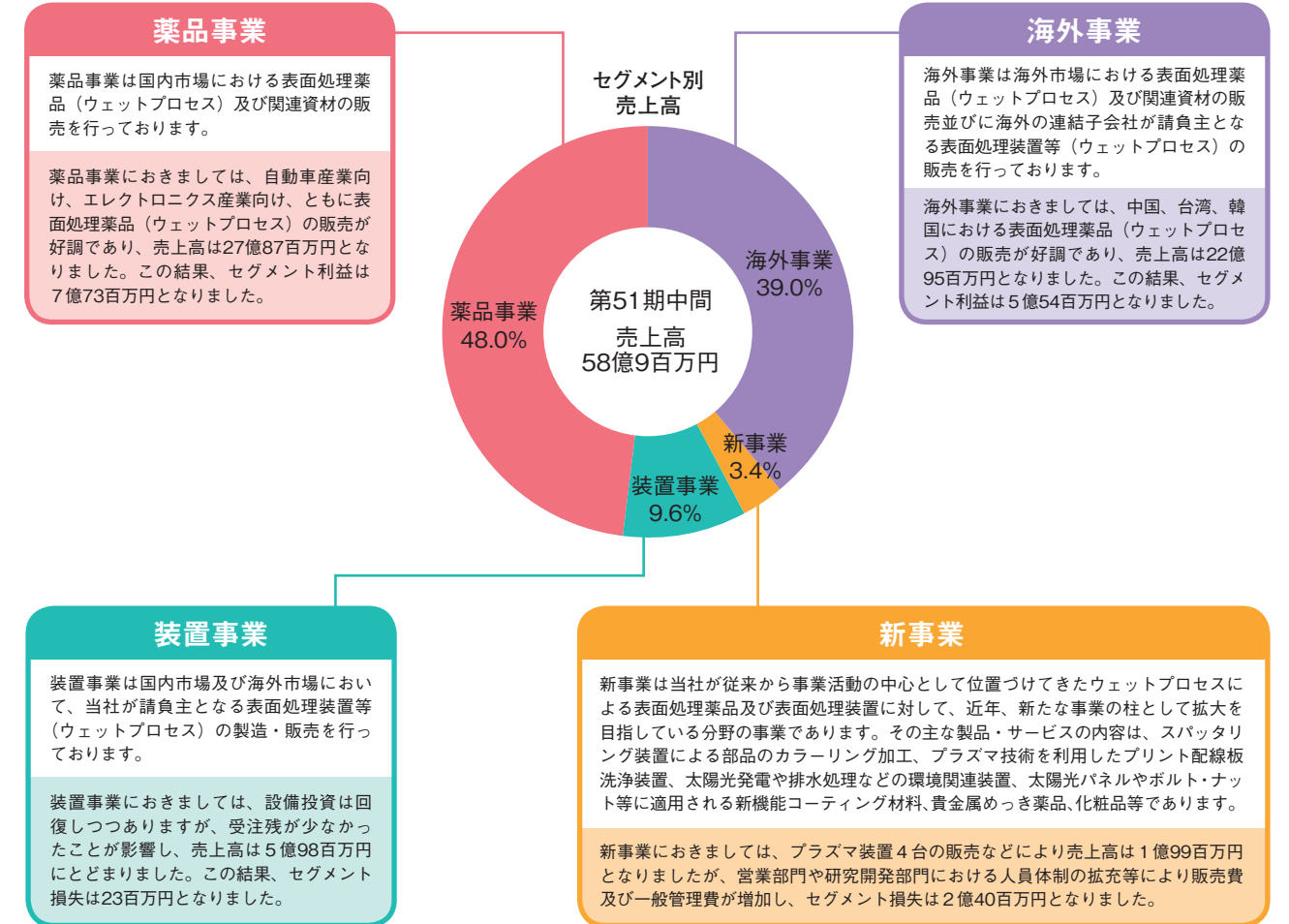
国内外の大手プリント配線板メーカーに相次いで採用が決まり、エニーレイヤー時代には必要不可欠な装置と考えられております。国内はもとより、台湾の大手配線板メーカーも高い関心を持っており、11月より台湾桃園にある子会社のサービスマンテナンス拠点において、台湾TPCA Showに展示した実機によるテスト基板加工サービス事業が開始されます。従いまして、今後大きな受注が期待できるものと確信しております。

上半期を通じて円高、ドル安傾向の中で推移いたしました。前期に推進実施しました薬品の現地生産化により為替差損は最小限度に抑えられたと自負しております。しかし、装置部門の現地生産化が少々遅れ、装置の売上が国内投資の不振もあり、予想通りに上らなかったため、薬品の大幅な売上増にも拘わらず、上半期は売上高だけが予想を残念ながら上廻ることができませんでした。しかし、逆にその分売上総利益率は大幅に改善され、10%以上の通期予想となりましたので、ご理解とご安心を賜りたくお願い申し上げます。更にここに来て、装置の受注残が海外向けに増えておりますので、ご安心ください。株主・投資家のみなさまにはなお一層のご支援、ご協力を賜りますよう重々お願い申し上げます。

2010年12月

代表取締役会長兼CEO 粕谷 佳允

第1四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年3月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成20年3月21日)を適用することによって、当社のセグメントの構成単位が下記のように変更となりました。



上記の円グラフにある各事業の構成比は内部取引相殺後の比率であります。

## 戦略マーケティング部 課長 萩原秀樹（工学博士）の目から見た エニーレイヤー技術が当社へ与える恩恵

### エニーレイヤーって何？

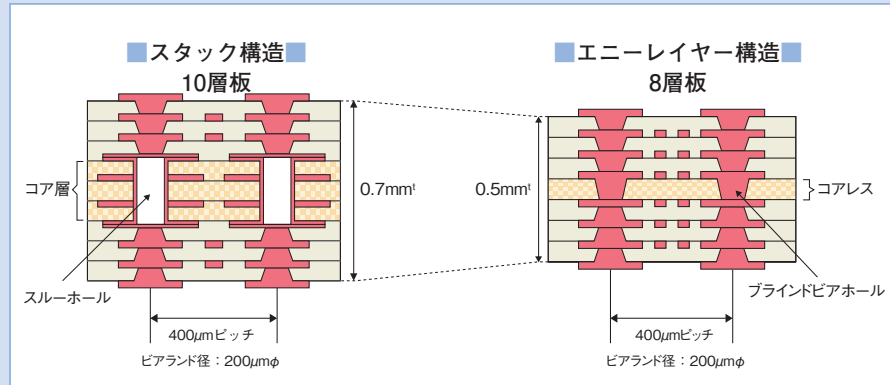
英語で表現すると「Any Layer」任意の多段層設計が可能という意味です。プリント配線板の世界では、複数枚の配線板を積み重ねた基板を、特に「ビルドアップ基板」と呼称し、近年の基板性能向上には必須工法となっています。この方法を用いれば、小さな電子機器でも複雑な機能を付与することが可能になります。しかし、この工法においてもビルドアップする前のベース多層基板（以下：コア材）には貫通穴（以下：スルーホール）が開けられ、その穴には壁面だけに銅めっきをするスルーホールめっきが実施されています。その後、インク材でスルーホール内部を全て充填した後に、その上下面方向へ貫通しない穴（以下：ブラインドビアホール）を設けて各層間の導通を確保していきます。パソコンやデジカメなどの周辺部品には、この方法で十分な性能向上が得られています。しかしながら、昨今注目されているスマートフォンや電子書籍のような高性能モバイル端末には不十分とされています。その大きな要因は「コスト」と「薄板化」です。スルーホールは機械式ドリルで作製されるため、どうしても穴のサイズが大きくなってしまいます。

それに対し、エニーレイヤー工法ではこのドリルを用いません。代わりにCO<sub>2</sub>レーザーを用い、安価で小径のブラインドビアだけで自由に各層間を接続できます。これによりスルーホールに掛かっていたコストが削減でき、同時にビルドアップ基板の薄板化も可能となります。

### スタック構造とエニーレイヤー構造の比較

めっき法による多段のエニーレイヤー工法が2010年より一部の製品で採用されたことにより、2011年から他の製品への応用展開が予想されます。下の図で、既存のスタック構造とエニーレイヤーの違いを見てみましょう。

両者の違いがお分かりでしょうか？左の図に示されているのはコア材にスルーホールが用いられている従来の構造です。一方、右の図にはスルーホールはもとより、そもそもコア材が存在しません。レーザーによるブラインドビアホールだけで各層間を自由に接続できるのがエニーレイヤー構造なのです。すなわち、このエニーレイヤー構造を用いれば、同じランド径及びピッチ回路形成を行う際に、コストダウンとなる層数の低減と、それに伴う製品の軽薄短小化へ寄与する基板の薄板化が可能になります。



### エニーレイヤー技術の特長

次に、この工法の特長を以下にまとめます。

- ・配線設計デザインの自由度が高まる。
- ・配線の密度が向上できる。
- ・従来のスルーホールとブラインドビアホールの両方処理に比べると、ブラインドビアホールだけで済むため、大幅にコストの削減ができる。
- ・ビルドアップ基板を薄くできるため、製品の薄型化・軽量化が可能となる。
- ・電気伝導性及び放熱性に優れる。

### エニーレイヤー技術の用途

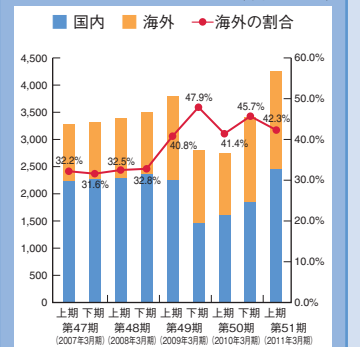
2010年は一部の高級スマートフォンや電子書籍のモバイル端末に採用されました。今後エニーレイヤー技術はこれらモバイル端末以外に、安価で高性能な小型電子機器分野へも適用が広がっていくことが期待されます。

### エニーレイヤー技術による当社売上への影響

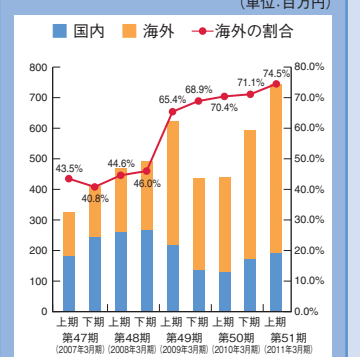
当社の薬品は、自動車分野と電子分野の2つの大きなマーケットで販売されています。特に電子分野の薬品には多くの種類がありますが、その中でもビアフィリング銅めっき薬品が当社の強みです。前述からも分かるように、ここで紹介したエニーレイヤー技術には、各層間を接続するブラインドビアホールを、何らかの電気伝導性に優れる金属で充填しなければなりません。最近の研究で「導電性ペーストは純銅である銅めっき皮膜に比べ、電気伝導性に難がある。」との報告から、エニーレイヤー技術にはビアフィリング銅めっきが注目されています。

調査会社による2009年の世界ビルドアップ基板の生産量と、そこに使用されるビアフィリング銅めっき生産量から推定して、当社ビアフィリング銅めっき薬品のシェアは、金額ベースで世界のおよそ40～50%を占めているものと思われます。今後エニーレイヤー技術の発展により、当社シェアの更なる拡大が予想されます。日本国内では、消費の低迷や円高に端を発した経済不況により、薬品販売の売上高は横ばいの状態にあります。その一方で、生産においても、消費においても世界経済を牽引している中国市場、またハイエンドメーカーの集中している台湾や韓国市場において、当社の薬品販売は好調を維持しております。更なる海外市場の開拓により、これまで以上の売上高が期待できるものと考えております。

### 薬品売上高推移 (単位:百万円)



### ビアフィリング薬品売上高推移 (単位:百万円)



# 連結財務諸表 (要旨)

Consolidated Financial Statements

## 連結貸借対照表

区分	当中間期末 2010年9月30日現在	前期末 2010年3月31日現在
<b>【資産の部】</b>		
流動資産	<b>6,829,911</b>	<b>6,137,616</b>
現金及び預金	2,215,607	2,071,624
受取手形及び売掛金	3,421,451	2,843,309
商品及び製品	489,187	483,492
仕掛品	23,695	93,299
原材料及び貯蔵品	210,864	207,024
繰延税金資産	206,985	175,987
その他	291,281	290,835
貸倒引当金	△ 29,161	△ 27,956
固定資産	<b>4,946,016</b>	<b>4,718,834</b>
有形固定資産	3,079,507	2,813,310
無形固定資産	384,084	416,425
投資その他の資産	1,482,424	1,489,097
<b>資産合計</b>	<b>11,775,928</b>	<b>10,856,450</b>

(単位:千円)

区分	当中間期末 2010年9月30日現在	前期末 2010年3月31日現在
<b>【負債の部】</b>		
流動負債	<b>3,673,567</b>	<b>3,538,957</b>
支払手形及び買掛金	1,797,500	1,742,731
短期借入金	162,629	551,205
一年内返済予定長期借入金	747,972	548,004
リース債務	13,243	12,572
未払法人税等	233,312	138,031
賞与引当金	226,298	179,410
前受金	133,419	14,490
その他	359,192	352,512
固定負債	<b>2,456,572</b>	<b>1,807,118</b>
長期借入金	1,510,360	1,017,658
リース債務	172,123	179,612
退職給付引当金	522,902	502,208
資産除去債務	159,829	—
その他	91,357	107,639
<b>負債合計</b>	<b>6,130,140</b>	<b>5,346,076</b>
<b>【純資産の部】</b>		
株主資本	<b>6,043,136</b>	<b>5,822,269</b>
資本金	1,176,255	1,176,255
資本剰余金	1,128,904	1,128,904
利益剰余金	3,738,057	3,517,191
自己株式	△ 81	△ 81
評価・換算差額等	△ 422,690	△ 332,973
その他有価証券評価差額金	△ 107,269	△ 82,001
為替換算調整勘定	△ 315,420	△ 250,971
少数株主持分	<b>25,341</b>	<b>21,077</b>
<b>純資産合計</b>	<b>5,645,787</b>	<b>5,510,374</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>11,775,928</b>	<b>10,856,450</b>

## 連結損益計算書

区分	当中間期 (自 2010年4月 1日 至 2010年9月30日)	前中間期 (自 2009年4月 1日 至 2009年9月30日)	前期 (自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日)
売上高	<b>5,809,424</b>	<b>4,191,109</b>	<b>9,197,729</b>
売上総利益	<b>2,959,873</b>	<b>1,889,840</b>	<b>4,181,003</b>
販売費及び一般管理費	<b>2,287,470</b>	<b>1,742,430</b>	<b>3,654,356</b>
営業利益	<b>672,402</b>	<b>147,409</b>	<b>526,647</b>
経常利益	<b>660,371</b>	<b>193,044</b>	<b>548,025</b>
税金等調整前四半期(当期)純利益	<b>531,430</b>	<b>90,500</b>	<b>443,300</b>
四半期(当期)純利益	<b>319,169</b>	<b>59,950</b>	<b>292,958</b>

(単位:千円)

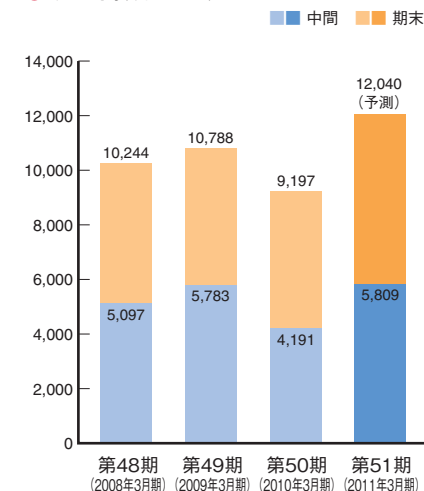
## 連結キャッシュ・フロー計算書

区分	当中間期 (自 2010年4月 1日 至 2010年9月30日)	前中間期 (自 2009年4月 1日 至 2009年9月30日)	前期 (自 2009年4月 1日 至 2010年3月31日)
営業活動による キャッシュ・フロー	<b>146,287</b>	<b>△ 224,481</b>	<b>128,124</b>
投資活動による キャッシュ・フロー	<b>△ 196,268</b>	<b>△ 152,834</b>	<b>△ 986,272</b>
財務活動による キャッシュ・フロー	<b>205,109</b>	<b>△ 313,729</b>	<b>148,119</b>
現金及び現金同等物 に係る換算差額	<b>△ 17,634</b>	<b>21,322</b>	<b>21,445</b>
現金及び現金同等物 の増減額	<b>137,493</b>	<b>△ 669,722</b>	<b>△ 688,583</b>
現金及び現金同等物 の期首残高	<b>1,808,164</b>	<b>2,496,748</b>	<b>2,496,748</b>
現金及び現金同等物 の四半期末(期末)残高	<b>1,945,657</b>	<b>1,827,026</b>	<b>1,808,164</b>

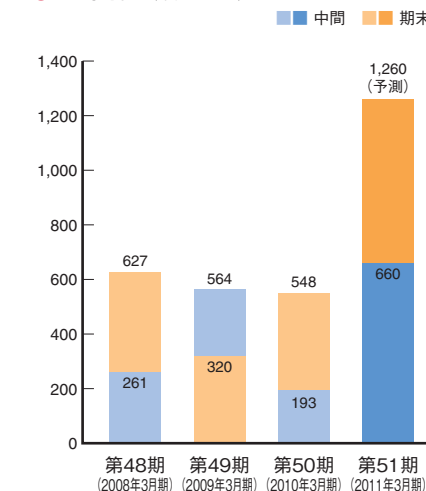
(単位:千円)

## 財務ハイライト (連結)

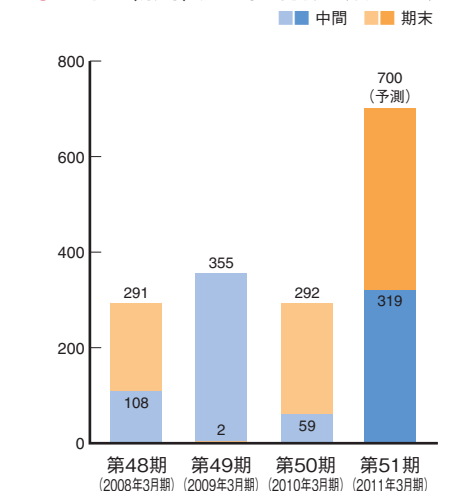
● 売上高 (単位:百万円)



● 経常利益 (単位:百万円)



● 四半期(累計)及び当期純利益 (単位:百万円)



株主優待制度変更に関するお知らせ

平成22年6月22日にお知らせしたように、株主優待制度を変更させていただきました。従来は、100株以上保有の株主様を対象に年2回、カタログから2,500円相当の商品をお選びいただいておりますが、変更後は毎年3月31日現在の株主様に保有株式数に応じて5,000円～15,000円の商品をお贈りさせていただきます。

従いまして、次回の優待は平成23年3月31日現在の株主様に6月下旬にカタログを発送させていただきます。変更後は下記のとおり、3つのランクが設けられ、金額も最高15,000円に上りました。是非このチャンスをお見逃しなくご利用ください。



100株以上500株未満  
5,000円相当の品



500株以上1,000株未満  
10,000円相当の品



1,000株以上  
15,000円相当の品

当社ホームページのご紹介

投資家の方、お客様、就職の方及び一般の方へのコミュニケーションの手段として、より正確、迅速に当社の経営者の考え方や事業内容、技術発展、マーケットでの強みなどの情報を伝えるように、当社は常にホームページの充実を図っております。



アドレス：http://www.jcu-i.com

主要コンテンツのご紹介

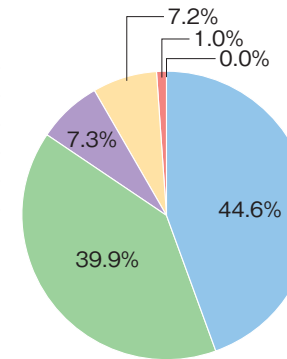
- 会社情報 経営者メッセージ、会社概要、会社沿革、事業内容、採用情報などのサブメニューを設け、会社についての一般情報を掲載しています。
- 商品情報 表面処理薬品と装置のご紹介を行い、新商品情報の随時更新を心がけています。
- 投資家情報 経営者からのメッセージ、東証や財務局への開示資料、財務・業績関連情報、株主優待・株式関連情報などをタイムリーに更新しています。社内技術情報のご紹介、出展する展示会情報を掲載しています。
- HELLO?

●株式の状況

発行済株式総数 ..... 3,640,900株  
株主数 ..... 6,175名

●所有者別株式分布状況

個人・その他	1,625,136株	44.6%
その他国内法人	1,452,600株	39.9%
金融機関	266,000株	7.3%
外国人等	262,231株	7.2%
証券会社	34,896株	1.0%
自己名義株式	37株	0.0%



●大株主の状況

株主名	持株数(株)	出資比率(%)
粕谷佳允	166,900	4.5
エフ ビー エフ 2000, エル. ビー.	113,500	3.1
日本パーライジング株式会社	113,500	3.1
日本高純度化学株式会社	110,000	3.0
荏原実業株式会社	100,000	2.7
株式会社S・D・PA	100,000	2.7
日本化学産業株式会社	93,000	2.5
中央化学産業株式会社	85,000	2.3
神谷理研株式会社	80,000	2.1
栄電子工業株式会社	80,000	2.1
株式会社ユニゾーン	80,000	2.1

(注) 出資比率は自己株式(37株)を控除して計算してあります。

- 商号 荏原ユーザライト株式会社
- 本社所在地 東京都台東区台東四丁目19番9号 山口ビル7
- 設立 1968年(昭和43年)4月1日
- 資本金 1,176,255,128円
- 事業所 【国内】  
大阪支店 名古屋支店 高崎支店 浜松営業所  
九州営業所 総合研究所 新潟工場 藤沢工場  
【連結子会社】  
・荏原ユーザライト(上海)貿易有限公司  
広州分公司  
・荏原ユーザライト貿易(深圳)有限公司  
蘇州事務所  
・台湾荏原ユーザライト股份有限公司  
・EBARA-UDYLITE (KOREA) CO., LTD.  
・EBARA-UDYLITE (ASIA-PACIFIC) CO., LTD.  
・EBARA-UDYLITE AMERICA, S.A.DE C.V.  
・EBARA-UDYLITE VIETNAM CO., LTD.  
・EBARA-UDYLITE (HONG KONG) CO., LTD.  
【関連会社】  
・PROGRESSIVE EU CHEMICALS PVT. LTD.  
・JCU Nanomate 株式会社  
・深圳森荏真空镀膜有限公司

- 役員一覽  
代表取締役会長兼CEO 粕谷 佳允  
代表取締役社長兼COO 小澤 惠二  
専務取締役専務執行役員 大木 繁司  
専務取締役専務執行役員 上谷 正明  
常務取締役常務執行役員 中澤 隆司  
常務取締役常務執行役員 君塚 亮一  
常務取締役常務執行役員 山本 雅司  
取締役常務執行役員 中村 憲二  
取締役常務執行役員 木村 隆男  
執行役員 吉川 豊  
執行役員 福島 敏明  
執行役員 小林 幹司  
常勤監査役 大野 寛二  
社外監査役 伴 峰夫  
社外監査役 岸 富也  
社外監査役 高中 正彦

- 従業員数 連結 358名(55名) 単体 256名(14名)

(注) 臨時雇用者数(パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含みます)、年間の平均人員を( )外数で記載しております。